



行业动态
Industry News



应用材料将收购Semitool 瞄准晶圆级封装和铜互连

2009-12-04 | 编辑: | 【大】 【中】 【小】 【打印】 【关闭】

作者: David Lammers, News Editor

Applied Materials Inc.(应用材料, 加州Santa Clara)表示, 将耗资约3.64亿美元收购Semitool Inc.(Kalispell, Mont.), 以增强公司在两大快速增长市场的地位: 晶圆级封装(WLP)和存储器产业向铜互连工艺的转变。

应用材料称, 将为每股Semitool股票支付11美元, 较后者周一收盘价8.40美元溢价31%。该公司首席执行官麦克·斯普林特(Mike Splinter)在一份声明中表示: “通过此项收购, 应用材料将帮助世界领先的芯片制造商生产体积更小、功能更强大的设备。”

Semitool总部位于蒙大拿州的Kalispell, 供应电化镀层及晶圆表面预处理设备及产品。该公司2008财年营收将近2.40亿美元, 但2009财年营收降至1.39亿美元, 该公司的2009财年截止于9月30日。

这次收购将加剧应用材料与Novellus Systems Inc. (San Jose)在铜淀积领域的竞争, 也使得应用材料在封装领域获得一部分新的客户。

Semitool将成为应用材料硅系统集团(SSG)的一部分。应用材料和Semitool在合作开发芯片制造设备解决方案方面曾经有过很强的合作记录, 应用材料SSG总经理Randhir Thakur表示。

Semitool董事长Ray Thompson说, 作为应用材料的一部分, 我们能加快使全球客户采用Semitool开发和提供的技术与设备, 并为公司的员工带来更光明的未来, 也会为股东创造额外的价值。

Gartner Inc.的设备分析师Dean Freeman表示, 收购将使得应用材料在铜淀积领域有了新的起点, 两年前该部门曾被放弃, 原因也一直未完全透露过。而Semitool在2008年已经占据了铜双大马士革淀积24%的市场份额, 营收达到了3000万美元, 而Novellus则占据了73.6%的份额, 其销售额为9240万美元。此次的



Semitool的Raider ECD (铜电镀) 工具用于晶圆级封装中。

- ▣ 科普首页
- ▣ 微电子历史
- ▣ 行业动态
- ▣ 术语解释
- ▣ 无微不至
- ▣ 芯片制程
- ▣ 科普创意

收购，也将拉开Applied/Semitoool与Novellus之间在铜工艺领域对决的序幕。

根据Gartner的数据，在使用金电镀和其他金属材料电镀以制造倒装芯片封装（flip-chip packaging）用凸点上，Semitoool拥有86%的绝对市场份额，2008年营收达到6300万美元。跟随其后的是 Nexx Systems Inc.(Billerica, Mass.)，拥有14%的市场份额。而在3-D互连TSV深孔填充方面，Semitoool和Ebara Corp. (Haneda, Japan) 各占有约34%的份额。

当应用材料放弃其电镀方面的开发工作时，他们与Semitoool一起合作为客户进行服务，尤其是在存储器领域，铜互连正在成为趋势。Semitoool的电镀设备已经销往AMD(Sunnyvale, Calif.) 和Micron Technology Inc. (美光科技，爱达荷州Boise)，进行存储器和CMOS图像传感器制造。“与应用材料交易，Semitoool则可继续将设备推向三星、Hynix和Elpida，”Freeman表示。Semitoool极大的依赖于代理商，这对于超大型的存储器客户来说，这显得相当微小；然而，应用材料则可以做到这些。

收购的时间将在应用材料和Semitoool都结束其2009财年的订单之后。为使此项交易获得批准，应用材料需要Semitoool三分之二的股东接受其要约。Semitoool大约32%的股票掌握在其董事及高管手中，而这些人已同意接受要约。应用材料预计将很快对剩余股票展开一次要约收购，并预计将于今年年底之前完成收购。

设备产业一直都在整合中，而生存下来的业者则会从中获利，Freeman表示。“我所担心的是，Semitoool乐于在极小的合适的小生境中发展，并获得利润；而应用材料却不愿意那样做。Semitoool身上所表现的某种牛仔文化会渐渐消失。”Freeman说。

Semitoool是Kalispell地区最大的雇主，而随着应用材料将其部分设备制造业务迁往亚洲的新加坡、中国及其他地区，在Montana州的设备制造业的长远未来可能会变得危险，他补充说。

应用材料SSG业务主管Thakur强调说，应用材料的客户在寻求晶圆级封装的解决方案，而前道的晶圆厂和后道的封装的界限正变得模糊。引用Gartner的数据，Thakur说，对于晶圆级封装和凸块晶圆正在被采用的一些市场，预计明年市场规模将达到约5亿美元，到2012年将增长到8亿美元。应用材料将整合来自Semitoool的电镀设备和自身现有的淀积、平坦化、刻蚀工具，服务于晶圆级封装应用。

Thakur表示，Semitoool的设备将继续在Kalispell制造，并使用应用材料的基础设施来支持Kalispell的制造厂。

应用材料的CEO Mike Splinter说，“封装处于一个新的转折点上，正从芯片级（die level）向晶圆级转移。在先进封装方面，我们已经与Semitoool进行过技术开发合作，我们非常欢迎这个新公司的加入。”

（来源：半导体国际 2009年11月18日）

